

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2020-008

天水华天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 2,740,003,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号		甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号
电话	0938-8631816	0938-8631990	
电子信箱	htcwy2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

报告期，公司的主营业务为集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM（MCP）、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-out 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司为专业的集成电路封装测试代工企业，主要经营模式为根据客户要求及行业技术标准和规范，为客户提供专业的集成电路封装测试服务。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

2019 年上半年，集成电路行业总体呈现需求低迷态势，下半年开始，在 5G 商用、国产替代等有利因素带动下，行业景气度开始回升，公司产能利用率逐步提高，效益逐季提升。

（二）公司所属行业情况

公司所属行业为集成电路行业，集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。对于集成电路垂直分工的商业模式，由设计公司完成设计集成电路后委托给芯片制造厂生产晶圆，再委托封测厂进行封装测试，然后销售给电子整机产品生产企业。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模位列全球集成电路封测行业前十大之列。

从集成电路产业发展的历史情况来看，集成电路市场具有一定的周期性，但近几年来，随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高，与全球经济增长的联动性有所增强。

近年来，受益于计算机、通信和消费电子以及节能环保、物联网、新能源汽车等新兴领域的发展，我国集成电路产业增长强劲。随着市场需求的快速增长、集成电路应用领域的不断拓展、技术水平的不断提高，以及国家、地方相关产业政策与资本的有力支持和集成电路国产替代加速的背景下，我国集成电路产业发展速度仍领先于全球半导体产业，继续保持增长势头。国内集成电路产业技术不断提升和巨大的市场需求带动了集成电路设计业、制造业及封装测试业的持续发展。

从 2019 年我国集成电路产业结构来看，设计业销售额为 3,063.5 亿元，同比增长 21.6%；制造业销售额为 2,149.1 亿元，同比增长 18.2%；封装测试业销售额 2,349.7 亿元，同比增长 7.1%。虽然我国集成电路产业规模增长迅速，但集成电路产业进口依赖严重，已连续多年超过原油成为我国第一大进口商品。根据海关总署统计数据，2019 年我国进口集成电路 4,451.3 亿块，进口金额 3,055.5 亿美元；而同期出口集成电路 2,187 亿块，出口金额 1,015.8 亿美元。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	8,103,490,628.12	7,121,706,261.65	13.79%	7,009,876,085.85
归属于上市公司股东的净利润	286,794,698.21	389,826,128.22	-26.43%	495,169,978.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,608,683.08	307,687,586.37	-50.73%	423,416,413.07
经营活动产生的现金流量净额	1,765,034,058.08	1,133,031,257.10	55.78%	903,535,927.95
基本每股收益（元/股）	0.1134	0.1639	-30.81%	0.2083
稀释每股收益（元/股）	0.1134	0.1639	-30.81%	0.2083
加权平均净资产收益率	4.30%	7.07%	-2.77%	9.67%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	16,044,968,730.79	12,442,682,421.66	28.95%	9,366,444,197.41
归属于上市公司股东的净资产	7,768,107,631.71	5,694,557,262.53	36.41%	5,346,960,275.79

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,711,326,979.16	2,128,003,452.79	2,267,280,695.13	1,996,879,501.04
归属于上市公司股东的净利润	16,657,858.90	68,952,308.58	81,985,165.50	119,199,365.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	830,028.55	24,113,781.74	58,174,190.92	68,490,681.87
经营活动产生的现金流量净额	113,984,808.36	355,395,288.05	455,850,217.38	839,803,744.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

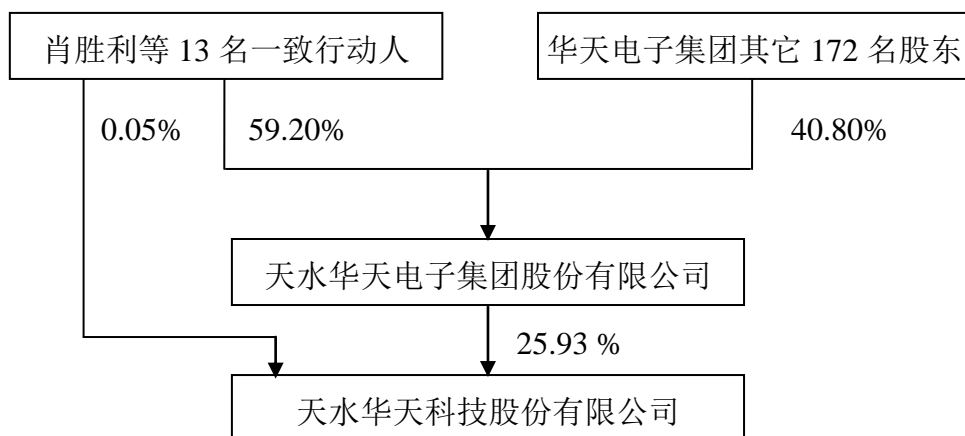
报告期末普通股股东总数	160,227	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	305,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	25.93%	710,365,699	0	质押	69,062,268	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	34,485,559	0			
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	1.09%	30,000,000	0			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L-CT001 深	其他	0.86%	23,699,795	0			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.81%	22,284,792	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	21,099,364	0			
全国社保基金一一四组合	其他	0.68%	18,732,958	0			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	18,549,902	0			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	18,499,659	0			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	0.67%	18,489,520	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		<p>报告期末，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 33,191,950 股股份，占公司总股份的 1.21%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 27,104,100 股股份，占公司总股份的 0.99%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,931,779 股股份，占公司总股份的 0.98%；国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 25,808,229 股股份，占公司总股份的 0.94%</p> <p>以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。</p>					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1) 概述

根据中国半导体行业协会引用 WSTS 数据，2019 年全球半导体市场销售额 4121 亿美元，同比下降了 12.1%。受 2019 年全球半导体市场同比下滑的影响，我国集成电路行业虽实现了同比 15.8% 的增长，但增幅较 2018 年的 20.7%、2017 年 24.8% 均大幅回落。2019 年我国封测业增速下降幅度最大，落后于设计和制造业以及集成电路行业的总体增速，全年增速不足两位数，回落至 7.1%。2019 年公司密切关注行业发展及客户需求，持续进行先进封装技术研发，推进南京封装基地建设和产业并购工作，不断提高管理水平和客户服务能力，综合竞争力不断增强。

2019 年公司共完成集成电路封装量 331.88 亿只，同比上升 24.19%，晶圆级集成电路封装量 85.15 万片，同比增长 50.98%，实现营业收入 81.03 亿元，同比增长 13.79%，营业利润 3.56 亿元，同比下降 27.11%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 160.45 亿元，同比增长 28.95%，归属于上市公司股东的净资产 77.68 亿元，同比增长 36.41%。

2019 年公司主要工作开展情况如下：

①继续发挥销售龙头作用，做好重点客户服务工作，大力开拓战略新客户。

报告期内，公司一方面做好重点客户的服务工作，保障订单稳定增长与新导入战略客户的量产，同时，有计划、有重点地加强行业知名企业和具有成长潜力用户的开发工作。报告

期内，公司新开发客户 146 家，实现与博世、瑞昱、江波龙等客户的合作，并批量供货。在与瑞昱实现合作后，台湾地区前十大 IC 设计企业中已有八家成为公司客户。

②借助与国际客户合作契机，进一步提升公司质量水平，加快推进与国际客户在汽车电子产品上的合作。

通过持续的质量改善，坚持产品全流程质量管控，建立制造与品质一体的质量管理架构，有效落实公司“质量第一”的理念。公司建立了完善的汽车电子管理体系，完成汽车电子专线建设，加快推进汽车电子产品的客户审核和量产。报告期内公司通过 ST、SEMTECH、PI 等汽车电子客户审核和产品验证，其中 ST 汽车电子产品通过 VDA 6.3 审核，达到 Grade A 级，并进入量产阶段，为汽车电子产品生产扩大规模打下了坚实基础。

③持续进行封装技术研发工作，不断增强公司科技创新能力。

报告期内，公司持续加大在 5G、大数据、高性能计算、IOT、汽车电子等领域的研发布局及投入。完成三维垂直互连硅基埋入式扇出封装技术（3D-eSiF0）的研发，实现 eSiF0 封装技术的三维垂直互连集成封装。完成基于 7nm 制程的高性能计算芯片的封装量产导入，同时配合客户开发基于 5nm 制程的高性能计算芯片的封装技术。开发了三维集成和超薄封装产品临时键合技术、3D NAND 存储器 16 层叠层封装技术、基于嵌入式散热片封装工艺的高散热要求的 BGA 封装技术。TSV 封装产品已通过安防及汽车电子客户认证，消费及安防领域实现了批量供货，汽车领域具备量产条件。在先进射频市场产品上，5G PA 产品完成开发和验证，进入小批量阶段。完成 SAW 滤波器、BAW 滤波器产品导入，实现批量生产。FO 产品进入市场推广阶段，LPDDR4 存储器已进入封装量产阶段。

本年度公司共获得国内授权专利 36 项，其中发明专利 17 项。“12 吋晶圆级埋入硅基板扇外型封装技术”荣获江苏省科学技术三等奖；“射频芯片硅基扇出封装技术”荣获第十三届（2018 年度）中国半导体创新产品和技术奖。

④加快华天南京一期等项目建设，公司产业布局不断完善。

报告期内，华天南京完成一期项目厂房建设，华天宝鸡引线框架生产线投产，华天昆山完成新建厂房建设，满足 CIS 产品扩产及 FC 产线建设需要。华天宝鸡、华天南京项目的陆续建设和投产，进一步完善了公司产业发展布局。

⑤完成配股融资工作，为公司募集发展所需资金。

报告期内，公司完成配股公开发行证券工作，共募集资金净额 16.4 亿元，所募集的资金用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。募集资金到位后，公司营运资金得到补充，并降低了公司资产负债率，提高偿债能力，促进公司经营规模和盈利能力进一步提升。

（2）主营业务分析

①营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,103,490,628.12	100%	7,121,706,261.65	100%	13.79%
分行业					
集成电路	7,861,032,171.55	97.01%	6,857,977,091.92	96.30%	14.63%
LED	242,458,456.57	2.99%	263,729,169.73	3.70%	-8.07%
分产品					
集成电路	7,861,032,171.55	97.01%	6,857,977,091.92	96.30%	14.63%
LED	242,458,456.57	2.99%	263,729,169.73	3.70%	-8.07%
分地区					
国内销售	3,357,948,458.99	41.44%	3,012,513,111.48	42.30%	11.47%
国外销售	4,745,542,169.13	58.56%	4,109,193,150.17	57.70%	15.49%

②营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路	营业成本	6,571,140,210.77	96.92%	5,710,786,510.01	95.83%	15.07%
LED	营业成本	209,151,772.44	3.08%	248,523,843.10	4.17%	-15.84%

③产量、销量情况

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
集成电路	销售量	万只	3,263,147	2,691,765	21.23%
	生产量	万只	3,318,763	2,672,430	24.19%
	库存量	万只	134,666	79,049	70.36%
集成电路	销售量	片	855,676	542,004	57.87%
	生产量	片	851,539	564,015	50.98%
	库存量	片	27,736	31,873	-12.98%
LED	销售量	万只	1,236,908	1,351,575	-8.48%
	生产量	万只	1,322,096	1,367,780	-3.34%
	库存量	万只	140,638	55,450	153.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

本报告期将 UMISEM 公司纳入合并范围使得集成电路产品销售量、生产量及库存量均增长。

本报告期 LED 产品销售量下降，库存量同比增长 153.63%。

(3) 下一年度经营计划

鉴于疫情对全球经济发展的不确定性和终端市场需求下降对半导体产业的影响，根据行业特点和市场预测，2020 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 90 亿元，生产经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状

况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

2020 年主要开展以下工作：

①坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的管理理念，加强与客户沟通交流，及时掌握市场动态，做好公司产能与客户订单的分解匹配，全面服务好国际客户和重点客户，确保已有客户订单稳定与增长。同时加大市场和客户拓展力度，积极争取潜在客户产品导入，扩大市场份额。

②继续与 Unisem 公司在客户资源、技术、生产经营等方面进行协作，进一步拓展公司在射频和汽车电子等领域的市场优势，形成合力，发挥整体优势。

③加快华天南京一期项目设备安装，做好华天南京投产和客户导入以及封装产品快速上量工作。

④以华为为标杆，加强与华为数字化转型咨询合作，借鉴华为成熟的方法论和管理实践，切实实施好华天科技数字化转型规划咨询项目，促进公司的运营和管理水平再上一个新台阶。

（4）未来面对的风险因素分析

①受半导体行业景气状况影响的风险

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，公司经营状况与半导体行业的景气状况紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。另外，随着集成电路封装测试行业的竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。

②产品生产成本上升的风险

公司产品主要原材料价格的波动会导致公司经营业绩出现一定的波动。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。

针对上述风险，公司未来将继续优化生产工艺流程，加大工艺升级力度，提高设备利用率；强化节能降耗和材料消耗管理，降低经营成本；提高生产自动化、信息化水平，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

③技术研发与新产品开发失败的风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发和新产品开发失败的风险。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展热点和用户需求的变化，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，分散和化解市场及研发风险。

④商誉减值风险

公司于 2019 年 1 月完成对马来西亚主板上市公司 Unisem 的收购。收购 Unisem 属于非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》，公司合并成本与可辨认净资产公允价值的差额确

认为商誉。若未来受宏观经济下行、半导体行业周期性波动、行业竞争加剧等因素影响，或 Unisem 自身技术研发、市场拓展、经营管理等方面出现重大不利变化，导致其经营状况不如预期，可能需要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将在市场、客户、技术、运营及人员等方面充分发挥与 Unisem 的协同效应，通过双方的有效整合，进一步增强公司和 Unisem 的持续盈利能力和在国际市场的竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

①会计政策变更及依据

1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业

务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见审计报告附注三、（十）（十一）。

2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

②会计政策变更的影响

1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	105,490,285.41	-105,490,285.41	
应收款项融资		105,490,285.41	105,490,285.41
可供出售金融资产	86,539,170.48	-86,539,170.48	--
其他非流动金融资产		260,686,757.65	260,686,757.65
递延所得税资产	59,066,841.58	-304,122.26	58,762,719.32
负债：			
短期借款	2,100,885,420.71	2,544,987.64	2,103,430,408.35
其他应付款	224,039,843.67	-4,606,470.62	219,433,373.05
其中：应付利息	4,606,470.62	-4,606,470.62	
一年内到期的非流动负债	392,563,600.00	2,061,482.98	394,625,082.98
递延所得税负债	6,001,105.95	25,075,975.31	31,077,081.26
股东权益：			
盈余公积	225,322,164.98	14,161,594.72	239,483,759.70
未分配利润	2,203,259,881.85	134,605,894.88	2,337,865,776.73

(续)

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	54,402,154.05	-54,402,154.05	
应收款项融资		54,402,154.05	54,402,154.05
可供出售金融资产	63,699,897.83	-63,699,897.83	
其他非流动金融资产		230,664,685.44	230,664,685.44
递延所得税资产	21,388,678.55	-304,122.26	21,084,556.29
负债：			
短期借款	1,545,000,000.00	1,868,392.02	1,546,868,392.02
其他应付款	180,563,912.34	-3,137,259.06	177,426,653.28
其中：应付利息	3,137,259.06	-3,137,259.06	
一年内到期的非流动负债	138,220,000.00	1,268,867.04	139,488,867.04
递延所得税负债		25,044,718.14	25,044,718.14
股东权益：			
盈余公积	225,322,164.98	14,161,594.72	239,483,759.70
未分配利润	1,670,520,906.18	127,454,352.49	1,797,975,258.67

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

①本公司与控股股东天水华天电子集团股份有限公司及马来西亚主板上市公司 UNISEM (M) BERHAD（以下简称“Unisem”）之股东 John Chia Sin Tet、Alexander Chia Jhet-Wern、Jayvest Holdings Sdn Bhd、SCQ Industries Sdn Bhd 以自愿全面要约方式联合收购 Unisem 公司股份，本次要约 Unisem 股东接受联合要约人要约的有效股份数为 428,553,254 股，占 Unisem 流通股总额 727,085,855 股的 58.94%，上述股份于 2019 年 1 月完成交割。本次要约取得的股份全部由公司通过全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司在马来西亚设立的全资子公司 HUATIAN TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 持有，Unisem 于 2019 年 1 月 31 日纳入本公司合并范围。

②本公司的全资子公司 FlipChipInternational,LLC 在美国设立的全资子公司 FlipChip-AD,LLC 于 2019 年 6 月 5 日注销。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇二〇年四月二十八日